

智慧物聯網晶片化整合服務計畫(lisC)

適用對象：不限，建議為國內外新創與中小企業

服務內容：

lisC 幫助廠商創意落實，縮短產品開發歷程/加速商品化，促進更多潛力產品投入智慧創新應用

技術服務

01

幫您解決IoT產品硬體設計或製造所面臨的疑難雜症，提供產品優化之技術諮詢服務

應用方案

02

可建議產品開發團隊選用最合適的IC應用方案，並提供相關技術支援與小量試產服務

產品試煉

03

媒合產品進入商業化場域試煉，整合意見貼近市場需求或取得關鍵數據與建模，建立Edge AI精準智慧化服務

提升終端產品價值



低功耗無線網路
微縮化封裝



AI邊緣運算
AI嵌入演算法



IP/IC設計
國產晶片方案



聯絡資訊：財團法人工業技術研究院

陳小姐 03-5913967

